

PCB	产品名称	产品型号	版本	页数	制定时间
焊接工艺要求	MDC3K	MDC3K 焊接要求	V2	1/1	2026-3-6
<ol style="list-style-type: none"> 完整阅读焊接要求，并且理解之后，再开始焊接； R189、R190 要先按照板图丝印成型，然后躺平焊接，距离线路板 1mm； C2 管脚需按焊盘位置成型，按外形轮廓图 躺平焊接； 整流桥 U4 要先成型，注意正负极，成型后的安装孔要正对齐，元件的远离线路板的一面 距离线路板 7mm； MOS 管 Q1 要先成型，有字的一面朝向线路板，安装孔要正对齐，其金属表面距离线路板 7mm； 功率模块 U1 元件的对角线管脚上有自然卡点，卡点紧贴线路板，元件金属面要完全平行于线路板，单点焊接固定后，确认金属面平行度，要求金属面与线路板的距离是 7mm，然后再开始焊接其他管脚； 接口插件要横平竖直； 洗板后，线路板的表面不能有锡珠、锡渣等残留物； 所有焊盘（焊锡）的高度、管脚的高度，均不能超过 2mm，超出一个点，则为不合格品； 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准 					
编制		审核		批准	
日期		日期		日期	